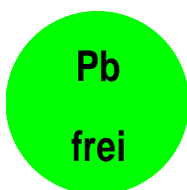


## Aktivgelötetes Kupfer auf AlN – AMB

|  |   |
|--|---|
| Kupfer   | O <sub>2</sub> -freies SE-Walzkupfer Reinheit 99,95% (DIN 1787) |
| Substrat                                       | ANCeram Aluminiumnitrid   |
| Substratdicke                                  | ≥ 0,635 mm  |
| Verbindungstechnik                             | Aktivlöten  |
| Schichtdicke (ätzbar)                          | bis 300 µm  |
| Fläche   | bis 4“ x 4“   |
| Schichtdicke (Stanzteile)                      | 0,4 mm bis 4,0 mm   |
| Leiterbahnstruktur                             | nach Anfrage bzw. unten genannten „Design Rules“                |
| Min. Leiterbahnbreite                          | 700 µm  |
| Min. Leiterbahnabstand                         | 500 µm  |
| Isolationswiderstand                           | >10 <sup>13</sup> Ωcm   |
| Flächenwiderstand                              | 1- 3 m Ω / □  |
| Durchschlagsspannung                           | > 16 kV/mm, 1 min   |
| Hafffestigkeit                                 | 60 Mpa ± 15 MPa (Vierpunktbiegung)                              |
| Lötbarkeit                                     | Weichlötbar   |
| Bondbarkeit                                    | Nickelschicht empfohlen (4 - 8 µm)                              |
| Thermowechsel für<br>2“ x 2“ x 0.04“ Substrate | > 200 Zyklen  |

Die genannten Daten und Empfehlungen entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Änderungen, bedingt durch Produktverbesserungen und Weiterentwicklung sind möglich. Genauere Angaben sind den unten genannten „Design Rules“ zu entnehmen oder müssen gesondert erfragt werden.

Stand 11/05



## Design Rules :

| <b>Strukturierte Seite :</b>    |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|
| Kupferdicke                     | 300 µm   | 200 µm   |
| min. Leiterbahnbreite           | 700 µm   | 500 µm   |
| min. Leiterbahnabstand          | 500 µm   | 400 µm   |
| Pullback                        | > 2,0 mm | >2,0 mm  |
| Eckradien                       |          |          |
| - außen am Layout               | ≥ R 5    | ≥ R 4    |
| - innen am Layout               | ≥ R 3    | ≥ R 2,5  |
| <b>Rückseite (vollflächig):</b> |          |          |
| Kupferdicke *                   | 300 µm   | 200 µm   |
| Pullback                        | ≥ 1,0 mm | ≥ 1,0 mm |
| Eckradien Cu                    | ≥ R 5    | ≥ R 5    |

\* je nach Flächenbelegung auf Leiterbahnbild

Bedingt durch die Strukturierungstechnik ist ein Ätzwinkel der Kupferkanten sowie ein Versatz zwischen Lot- und Kupferfläche von max. 100 µm möglich.



ANCeram GmbH & Co.KG  
Esbachgraben 21  
D-95463 Bindlach  
Info@anceram.de